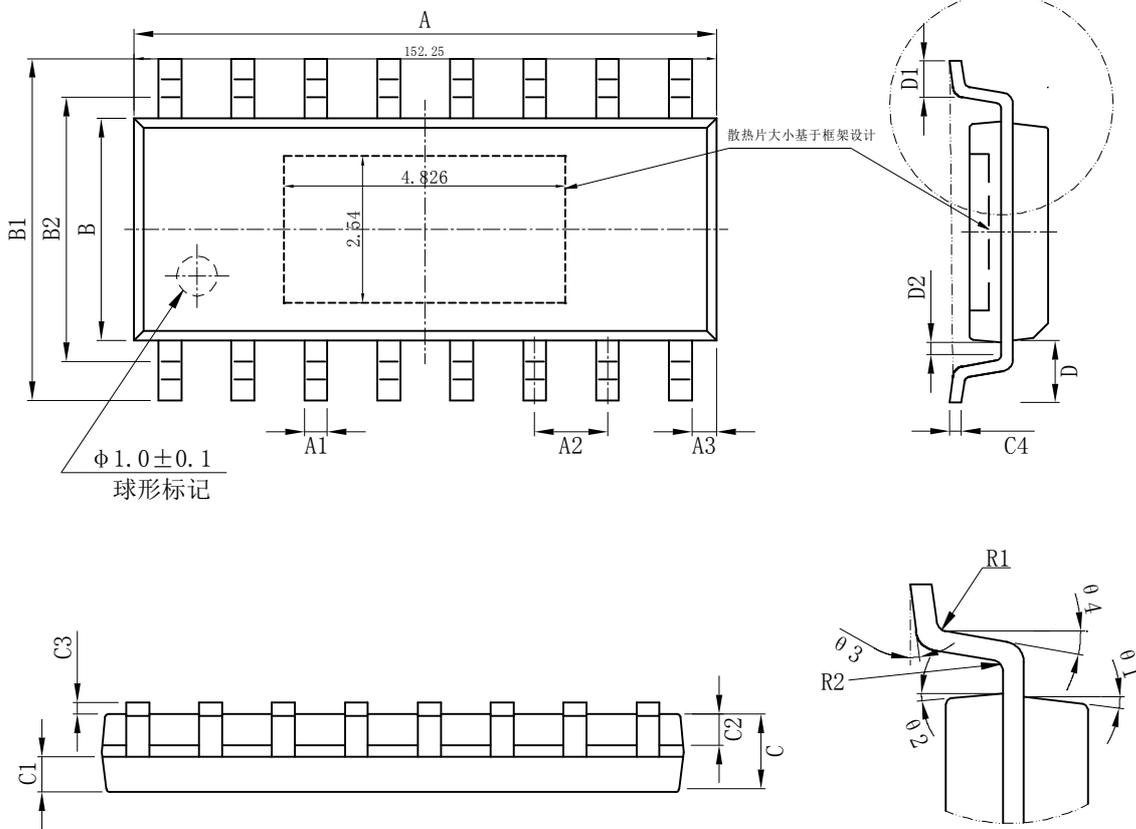




标注	尺寸	最小(mm)	最大(mm)	标注	尺寸	最小(mm)	最大(mm)
A		9.80	10.00	C3		0.05	0.15
A1		0.356	0.456	C4		0.203	0.233
A2		1.27TYP		D		1.05TYP	
A3		0.302TYP		D1		0.40	0.70
B		3.85	3.95	D2		0.15	0.25
B1		5.84	6.24	R1		0.20TYP	
B2		5.00TYP		R2		0.20TYP	
C		1.40	1.60	θ 1		8° ~ 12° TYP4	
C1		0.61	0.71	θ 2		8° ~ 12° TYP4	
C2		0.54	0.64	θ 3		0° ~ 8°	
				θ 4		4° ~ 12°	

\* ESOP Die pad exposur大小是根据引线框架设计。



制图	朱复国	2016.07.06	名称	生效日期		
审核			ESOP16 封装产品图	等级标记	重量	比例
批准						
单位	mm		图号	页数	第1页 共1页	
镀涂			C-0L-090	气派科技股份有限公司 CHINA CHIPPACKING TECH. CO., Ltd		
			版次			